

2026 年 6 月 3 日

公 司 名 尼得科精密检测科技株式会社
代 表 人 总裁 山崎 秀和
所 在 地 日本京都府向日市 Nidec Park 33 番地 C 栋

尼得科精密检测科技将参展 JPCA Show 2026

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将参加于 2026 年 6 月 10 日（周三）至 6 月 12 日（周五）在东京国际展览中心举办的“第 55 届国际电子电路产业展（JPCA Show 2026）”。



本次展会，我们将主要展示面向背钻的 X 射线检测解决方案，以及通过尼得科集团协同效应新推出的自动搬运机“EFEM (Equipment Front End Module)”。同时，我们还将展示顺应市场趋势、支持光模块和大型基板的新一代 AI 外观检测装置“AURCA 系列”。

现有的图像检测装置和电气检测装置也在实现更高的精度，我们提供能够满足前沿产品品质要求的整体检测解决方案。

〈参展概要〉

- 会期：2026 年 6 月 10 日(周三)～6 月 12 日(周五)
- 会场：东京国际展览中心 东展厅
- 展位：东 1-3 展厅 3F-33
- 官网：<https://www.jpca-show.com/show2026/>

〈参展内容〉

- | | |
|---|--------------------|
| · 面向 TGV (Through Glass Via) 的高精度检测解决方案 | · · · EFEM Series |
| · 面向背钻的高速 CT 型 X 射线检测机 | · · · GATS®-7837 |
| · Equipment Front End Module 全面板尺寸对应自动搬运机 | · · · GATS®-8370 |
| · 面向大型单片半导体封装的高精度检测装置 | · · · STAR REC® V6 |
| · 半导体封装多面贴装全面板基板检测装置 | · · · AURCA Series |
| · 大型/多引脚基板用导通绝缘检测装置 | · · · RSH Series |
| · 光模块·大型基板对应新一代 AI 外观检测装置 | · · · NS Probe |
| · 适用于高密度基板的 2D/3D 检测设备 | · · · NATS® Series |
| · 窄间距对应探针 | |
| · 功率半导体 芯片/器件检测系统 | |